

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年2月23日(2006.2.23)

【公開番号】特開2005-347770(P2005-347770A)

【公開日】平成17年12月15日(2005.12.15)

【年通号数】公開・登録公報2005-049

【出願番号】特願2005-212721(P2005-212721)

【国際特許分類】

H 05 K 1/14 (2006.01)

G 02 F 1/1345 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/14 F

G 02 F 1/1345

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月10日(2006.1.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1のプリント基板を供給する第1の供給手段と、予め液晶駆動素子が搭載されたタブが接続された液晶ガラス基板を供給する第2の供給手段と、前記第1の供給手段により供給された第1のプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する第1の貼付手段と、前記第2の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所と前記第1の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第1のプリント基板の所定箇所とを位置合せする第1の位置合せ手段と、該第1の位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブと異方性導電膜テープが貼付された第1のプリント基板とを圧着する第1の圧着手段とからなる第1の実装装置と、

この第1の実装装置に連続接続され、

第2のプリント基板を供給する第3の供給手段と、前記第1の圧着手段で前記第1のプリント基板に貼付された異方性導電膜テープがタブに圧着された液晶ガラス基板を供給する第4の供給手段と、前記第3の供給手段により供給された第2のプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する第2の貼付手段と、前記第4の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所と前記第2の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第2のプリント基板の所定箇所とを位置合せする第2の位置合せ手段と、該第2の位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブと前記第2の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第2のプリント基板とを圧着する第2の圧着手段とからなる第2の実装装置と

を備えたことを特徴とする部品実装装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

上記課題を解決するために、本発明の部品実装装置は、第1のプリント基板を供給する

第1の供給手段と、予め液晶駆動素子が搭載されたタブが接続された液晶ガラス基板を供給する第2の供給手段と、前記第1の供給手段により供給された第1のプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する第1の貼付手段と、前記第2の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所と前記第1の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第1のプリント基板の所定箇所とを位置合せする第1の位置合せ手段と、該第1の位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブと異方性導電膜テープが貼付された第1のプリント基板とを圧着する第1の圧着手段とからなる第1の実装装置と、この第1の実装装置に連続接続され、第2のプリント基板を供給する第3の供給手段と、前記第1の圧着手段で前記第1のプリント基板に貼付された異方性導電膜テープがタブに圧着された液晶ガラス基板を供給する第4の供給手段と、前記第3の供給手段により供給された第2のプリント基板に異方性導電膜テープを貼付する第2の貼付手段と、前記第4の供給手段により供給されたタブ付き液晶ガラス基板の所定箇所と前記第2の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第2のプリント基板の所定箇所とを位置合せする第2の位置合せ手段と、該第2の位置合せ手段により位置合せされた液晶ガラス基板のタブと前記第2の貼付手段により異方性導電膜テープが貼付された第2のプリント基板とを圧着する第2の圧着手段とからなる第2の実装装置とを備えたことを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

本発明の部品実装装置は、第1の実装装置と第2の実装装置とを連続配置して、供給されたタブ付き液晶ガラス基板にプリント基板を順次圧着する。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

以上説明したように本発明によれば、供給されたタブ付き液晶ガラス基板に、供給されたプリント基板を順次圧着実装するので、効率良くプリント基板を接続することができる。